公司代码:688049　　公司简称:炬芯科技

炬芯科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

3.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润204,586,027.73元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为239,201,666.65元，经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元人民币（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为174,280,495股，以此计算合计拟派发现金红利45,312,928.70元（含税）。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购额（以下简称“回购并注销”）金额2.00亿，现金分红和回购并注销金额合计62,740,978.20元，占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.67%。

截至2025年12月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份887,155股，不参与本次利润分配。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	炬芯科技	688049	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢枚芹	程奔驰
联系地址	珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区	珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区
电话	0756-3673718	0756-3673718
传真	0756-3392727	0756-3392727
电子信箱	investor.relations@actionsatech.com	investor.relations@actionsatech.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

作为中国领先的低功耗AI IoT芯片设计厂商，公司专注于中高端智能音频SoC芯片的研发、设计与销售，深耕无线音频、智能穿戴、智能交互等AIoT核心场景，为行业提供高能效比的专业芯片产品与一体化解决方案；公司坚定践行品牌客户战略，以持续高强度技术研发筑牢产品核心竞争力，推动市场份额稳步攀升。

依托全场景AI音频布局，公司已构建起低功耗大算力芯片硬件架构、高性能音频链路及音频算法、高带宽低延迟无线连接技术、便捷高效的端侧 AI 开发工具四大核心技术壁垒，并率先布局存内计算（CIM）技术，CPU+DSP+NPU架构实现AI算力高效加速，从底层架构突破传统计算模式的存储墙与功耗墙瓶颈，与端侧AI对高能效比、低功耗、实时推理的核心要求高度契合，形成软硬件协同、算法与连接技术深度融合的差异化优势。

未来，公司将围绕硬件升级、算法迭代优化、无线连接技术拓展、生态体系搭建四大核心维度持续加码研发投入，不断强化存内计算等前沿架构在智能音频终端的规模化落地优势，逐步拓展应用边界，致力于成长为端侧 AI 多领域的领先芯片供应商。

公司芯片产品用例展示：

公司的部分终端品牌客户：

注:公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

公司的核心产品：

（1）智能无线音频SoC芯片系列:公司的智能无线音频SoC芯片主要应用于蓝牙音箱、无线麦克风、智能穿戴设备、无线家庭影院音响系统、无线电竞耳机、无线收发dongle等。

（2）端侧AI处理器芯片系列:

公司致力于提供智能物联网AIoT端侧低功耗算力的芯片平台，聚焦于端侧A目技术在音频领域的深度落地与创新应用，可为声纹识别、智能降噪与人声增强、波束成形、定向拾音、人声分离、回声消除、去混响、反馈抑制、音效增强、声场定位与调校、定向传声、多音轨分离与重混(包括人声、乐器等)、人声美化、变声、灯效、智能场景识别、情感识别、语音唤醒与识别、语义分析等为代表的众多实际应用场景提供充足的AI算力，可广泛应用在以Party音箱以及声卡、调音台、专业麦克风、会议系统、无线家庭影院音响系统等为代表的专业音频设备中。

2.2主要经营模式

作为集成电路设计企业，公司采用行业常用的Fabless经营模式，即专门从事集成电路的研发设计，晶圆制造和测试、芯片封装和测试均委托专业的集成电路制造企业、封装测试企业完成，取得芯片成品后对外销售。同时，为了缩短芯片产品的面市时间，降低客户的开发门槛，公司在提供SoC芯片的同时，提供完善的SoC软件开发平台（算法库、OS、SDK、应用软件和开发工具等），针对不同品类的特性以及市场需求，为客户提供融合软硬件和算法的整体解决方案。

1.研发模式

公司研发流程如下：

在立项阶段，各事业部根据市场调研情况提出市场需求，各研发部门根据市场需求文档提出各自领域的研发需求以及技术创新需求，由项目经理组织各部门进行需求的可行性评估和立项评审。当项目评审通过后，项目正式立项。

在研发阶段，各事业部及研发部门共同讨论并制定芯片的设计规格书，SoC研发部根据规格书进行电路设计、仿真和版证、物理实现以及封装设计工作，完成所有工作后，召开Tape out评审会议；同时，系统研发中心和算法研发中心进行芯片应用方案的开发工作。在新产品Tape out评审会通过后，制造工程部委托晶圆制造厂、封装测试厂依照与量产流程相似的标准进行样品试生产，同时进行晶圆和封装测试环境的开发。样品完成后，各研发部门会进行芯片验证和样机测试，核实样品是否达到各项设计指标。

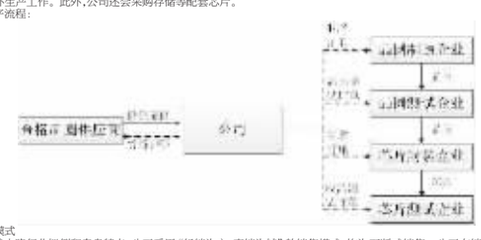
在新产品验证通过后，系统研发中心将发布应用方案级别的软件和硬件开发平台，开始进行客户端产品试量产。在试量产成功完成后，进入芯片量产阶段。

2.采购与生产模式

公司采用Fabless模式，主要负责集成电路的设计，因此需要向晶圆制造厂采购晶圆，向集成电路封装、测试企业采购封装、测试服务。

运营部依据业务部的出货预测制定相应采购计划和生产计划，并由晶圆制造厂和封装测试厂完成晶圆制造、晶圆测试、芯片封装测试等委外生产工作。此外，公司还会采购存储等配套芯片。

采购生产流程：



3.销售模式

根据集成电路行业惯例和自身特点，公司采用“经销为主，直销为辅”的销售模式，均为买断式销售。公司在销售过程中，除了提供SoC芯片，还可为客户提供融合软硬件和算法的整体解决方案。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。《国家集成电路产业发展推进纲要》指出，集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。近年来，随着人工智能、物联网、新能源汽车、智能穿戴等应用领域的不断发展，全球电子产品市场规模逐年扩大。据美国半导体产业协会（SIA）数据，2025年全球半导体销售额达到约7,917亿美元，预计2026年将首次突破1万亿美元。

2025年，国务院发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》指出到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，商务部等八部门联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》，聚焦供需双侧协同发力，明确提出加速人工智能终端产品创新，为端侧AI应用注入新动能。

（1）行业的发展阶段及基本特点

1.端侧音频设备AI化升级趋势显著

随着AI应用逐步爆发和商业化落地，未来AI将从“云端集中”走向“云边端协同”，核心趋势不再是单一算力中心的扩张，而是云端与端侧的深度融合与智能分发。云端的核心价值依然在于大规模训练与复杂逻辑的汇聚，但随着AI规模化应用的深入，单纯依赖云端所带来的算力成本激增、带宽瓶颈、高延迟以及隐私安全问题，正成为AI应用广泛落地的掣肘。随着端侧芯片算力的跃升与轻量化模型技术的突破，云端与端侧的深度融合正加速在消费电子领域落地。尤其在音频设备领域，高性能芯片让实时降噪、离线翻译、人声增强、多音轨分离、人声美化、语音识别等AI功能向以在本地运行，耳机、音箱、眼镜、麦克风、手表等产品正从单一的“播放/录制工具”进化为具备感知能力的智能人口，覆盖办公、娱乐、健康等全场景。上下游产业链正协同推动这一变革：行业竞争的核心正从单纯的硬件比拼，转向“硬件+AI模型+场景服务”的综合能力较量。云端与端侧的深度融合，不仅解决了隐私与延迟的痛点，更让端侧AI成为音频行业新一轮增长的关键引擎。

ii.无线通信呈现标准协议与私有协议共同蓬勃发展的趋势

近年来，物联网行业的蓬勃发展推动蓝牙、WiFi等标准协议加速渗透，其中蓝牙技术自1994年由爱立信提出后不断革新演进，蓝牙技术联盟SIG预计，蓝牙设备2025年度出货量将超54亿台，凭借低功耗、短距离通信优势，在音频设备、可穿戴设备、物联网等领域深度渗透，成为连接终端的基础协议之一。然而，标准协议的通用性设计使其在延迟控制上存在固有局限，难以满足对延迟有极致要求的场景需求。

因此，基于2.4G、5.2G、5.8G等ISM频段的私有通信协议，其核心价值正在于通过高度定制化设计，专门针对极致低延迟场景，精准填补标准协议的短板。不仅如此，在保障核心的低延迟特性基础上，私有协议在带宽表现上通常优于标准蓝牙，功耗控制上也往往优于WiFi，从而在满足低延迟刚需的同时，进一步提升了场景适配能力。目前，私有协议已在消费电子（如无线麦克风、游戏外设）、智能办公（低延迟协作设备）等领域广泛应用，成为标准协议的重要补充。市场上参与私有通信协议相关产品研发和生产的企业众多，既有国际知名的半导体企业，也有众多国内新兴的芯片设计公司，它们通过快速响应市场需求，提供了定制化解决方案和具有成本优势的产品，但其存在的核心意义，始终聚焦于解决标准协议在延迟控制上的瓶颈，成为低延迟场景下不可或缺的补充方案。

（2）主要技术门槛

集成电路设计的流程首先要进行软硬件划分，将设计基本分为两部分：芯片硬件设计和软件协同设计。高质量的芯片不仅需要在体积、容量、安全性方面满足市场要求，还需保证能耗、稳定性、抗干扰能力等诸多需求，因而集成电路设计公司既需要掌握各种元器件的应用特性，又需要以技术积累和行业经验为基础熟悉配套的软件技术。

随着端侧AI持续演进，芯片设计需适配端侧设备专用模型的部署需求。依赖小容量锂电池的端侧设备应用与市场规模庞大，多以中小模型完成AI推理，是混合式AI架构的关键未档。其AI化升级需同步推进两大核心：一是打造高能效比AI芯片，既可通过传统架构迭代制程实现功耗与面积优化，也可依托存内/近存计算等架构创新，在成熟制程上实现能效突破；二是部署适配的专用中小模型。同时，模型/算法适配与迁移不断深化，芯片设计企业提供高效易用的端侧AI开发平台，已成为推动设备AI化落地的关键支撑。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

经过多年在智能音频芯片领域的研发投入与技术积累，不断发展，公司拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，在所处行业的多领域内有显著的竞争优势。

公司的核心技术涵盖了高性能音频ADC/DAC技术、高性能低功耗的蓝牙通信技术、高带宽低延迟私有无线通信技术、高集成度的低功耗技术、高音质体验的音频算法处理技术、高度自主IP技术和高集成度SoC设计整合框架、高性能软硬件融合的系统平台技术、高能效比架构的AI加速引擎等。

公司SoC音频技术架构

（1）智能无线音频SoC芯片系列

① 蓝牙音箱市场

近年来，公司芯片实现对国内外友商的快速替代，在国际一线品牌市场份额显著提升，迅速跻身该领域头部企业行列。据洛图科技《中国蓝牙音箱零售市场月度追踪》显示，2025年上半年中国蓝牙音箱全渠道销量、销额同比分别增长3.9%，18.4%，产品均价同比提升13.9%，品牌蓝牙音箱销售表现显著优于白牌，贴牌产品；Futuresource市场分析报告预计，2025-2029年全球蓝牙音箱市场规模将增至79亿美元，尽管整体品牌竞争格局相对稳定，但在音质升级、AI音频功能创新等因素驱动下，市场蓝色结构性增长机遇，公司在该领域的份额仍有相对充足的增长空间。

目前，公司已与哈曼、索尼、LG、安克创新、维尔晶、荣耀、小米、罗技、雷蛇、漫步者等国内外主流终端品牌达成长期深度合作。其中，公司与哈曼的合作已实现多品类、多机型、大规模量产，深度覆盖JBL、Harman/Kardon等旗下高端产品线，成为哈曼在蓝牙音箱音频芯片领域的核心战略合作伙伴，充分彰显公司在全球高端音频芯片领域的技术领先性与头部市场地位。

公司核心产品涵盖ATS283X、ATS288X、ATS293X等高性能系列，凭借技术优势突出、品质稳定可靠、方案成熟度高的综合竞争力，可精准匹配并满足头部品牌严苛的差异化需求，持续获得国际一流品牌与 ODM/OEM 厂商的高度认可。

② 私有协议音频市场

私有协议音频市场是公司重点开拓的蓝海赛道，目前已全面覆盖无线麦克风、无线家庭影院音响系统、无线电竞耳机等核心细分领域，核心产品涵盖搭载存内计算技术的ATS323X系列，以及ATS3031、ATS2831PL系列等，精准匹配各细分场景的差异化需求。

作为无线麦克风领域的头部芯片供应商，公司的终以技术迭代引领行业创新：2022年率先推出第一代ATS2831P系列芯片，顺应无线麦克风小型化、轻量化趋势；2023年迭代的第二代ATS3031系列，助力品牌客户打造出当时全球体积最小、重量最轻的无线麦克风产品；2025年重磅发布的第三代ATS3231系列，更成为业界首个搭载无线监听功能的无线麦克风芯片方案，持续以技术突破定义行业新标准。依托20余年音频技术积淀，公司芯片性能达到行业标杆水准：支持全链路48KHz@32bit传输，DAC SNR高达120dB（底噪＜2μVrms）、ADC SNR达112dB（底噪＜3.6μVrms）；无线传输端实现端到端9ms低延迟，独创2.4G私有协议带宽达4Mbps，可灵活支持四发一收、两发四收、一发多收等多链接组网模式，搭配16dBm发射功率与新一代跳频技术，传输距离最远可达450米，传输稳定性与抗干扰能力稳居行业前列。在AI技术赋能下，基于存内计算技术的AI NPU算力引擎，实现高能效比、低失真度的多场景AI目适应降噪，大幅强化产品核心竞争力，目前已与大疆、RODE、猛玛等头部品牌深度合作，打造多款现象级产品，为内容创作者提供专业可塑的创新方案。未来五年，随着AI降噪、私有协议低延迟传输等技术的全面普及，无线领英爱将从专业设备转变为内容创作的标准化工具；应用场景将持续拓展，从传统的直播、短视频延伸至远程会议、在线教育及运动相机配件领域，催生出更细分的产品需求；在市场竞争格局上，国产品牌将在巩固中低端市场主导地位的同时向高端持续突破，并加速出海东南亚、印度、中东、拉美、非洲等新兴市场，从而推动全球产业规模稳步扩张。

在无线家庭影院音响系统市场，据Futuresource数据预计，2029年全球市场规模将达61亿美元，核心终端品牌涵盖三星、LG、索尼、Bose、哈曼、VIZIO、Hisense、TCL等。公司凭借高度集成的单芯片方案，将蓝牙音频接收、2.4G私有协议传输、音频解码与输出等关键模块一体化集成，大幅缩短信号处理路径，实现低至16ms的音频传输延迟，目前已成功搭载于TCL、VIZIO、Hisense等品牌产品量产上市。

在无线电竞耳机市场，随着无线传输延迟与稳定性的持续优化，无线化渗透率正加速提升。据Futuresource数据预计，2024年游戏耳机无线占比约为50%，预计无线技术将持续向低价市场渗透，到2028年这一比例将攀升至77%，对应全球游戏耳机营业额从2024年的26亿美元增长至2028年的33亿美元。公司敏锐把握电竞耳机市场的无线化转型机会，推出了极具竞争力的无线电竞耳机芯片方案，现已在国内外多家知名品牌成功量产落地，已成为国内头部电竞耳机品牌西伯利亚、迈从的核心供应商，公司将逐步完善产品矩阵，未来将持续拓展市场份额。

③ 智能穿戴市场

根据Omdia最新发布的行业数据，全球可穿戴设备市场在2025年出货量首次突破2亿台大关，较前一年增长6%。随着生成式AI与传感器技术的持续进步，穿戴设备正从心率监测、步数记录、信息推送、音频转输等基础功能，向数据融合处理、个性化健康监测、实时翻译交互等智能场景深度演进，智能腕戴市场仍将保持增长动力。

公司是智能手表SoC市场的主流供应商之一，公司智能穿戴SoC芯片广泛应用于手表/手环、AI眼镜等智能可穿戴产品，核心产品涵盖搭载存内计算技术的ATW609X系列，以及ATS3085、ATS3089系列等，精准匹配多元穿戴场景需求。公司凭借多年在低功耗技术、显示技术、蓝牙双模技术及音频技术的深厚积累，持续推动智能穿戴SoC芯片迭代升级，目前已成功应用于小米、荣耀、imoo、Noise、Titan、realme、Nothing、mentech、INMO、Halliday、形意智能等品牌的手表、手环、AI眼镜产品，获得市场广泛认可。

（2）端侧AI处理器芯片市场

AI 模型在音频领域拥有丰富的应用场景，涵盖语音识别、噪音抑制、语音翻译、AI 啸叫抑制、人声增强、人声分离、声纹识别、语义检测与识别等，以往需在手机、PC 乃至云端运行的音频AI模型，正逐步向端侧设备迁移落地。公司的端侧AI处理器芯片首先落地于音频产品的应用，基于多核异构AI计算架构，为小容量锂电池驱动的低功耗端侧音频设备提供高能效比AI算力，以满足终端设备日益增长的智能化需求。主要产品型号包括：搭载公司存内计算技术的ATS362X，以及ATS3609D、ATS361X等，目前ATS362X已搭载于头部品牌客户产品发布上市，ATS3609D、ATS361X已实现品牌客户产品落地，展现出优异的市场竞争力。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

智能无线音频芯片和端侧AI处理器芯片需要综合考量功耗、算力、连接性能、成本等多个方面，随着AI技术的深度融合，AI算法将在智能无线音频SoC芯片中得到更广泛应用，将会集成更强大的NPU，以更低功耗支持更大更复杂的AI模型，使产品在AI音频体验上更加自然流畅，同时无线连接技术应用上，为兼顾通用性和低延迟高效率，也将呈现通用的蓝牙、WiFi等协议与私有通信协议共存的情况。

①蓝牙技术规范持续升级，不断提升蓝牙设备效率和功能。蓝牙技术联盟SIG 发布的技术路线图公布了五大核心技术升级趋势：CS（信道探测）实现安全精确定位，赋能汽车数字钥匙、智能门禁等场景；ULL HID（超低延迟人机接口设备）支持1000Hz轮询率，优化游戏及AR/VR/MR设备响应；即将发布的HDT（高数据吞吐量）标准技术将实现最高速率达到7.5Mbps，满足大媒体流传输需求，同时加强版HDT标准技术正在讨论更高带宽的标准，持续在提高带宽能力；新增在审议的6/6GHz高频段的标准技术，为蓝牙的抗干扰等性能升级提供技术支撑；LE Audio增强技术升级无线音频平台，驱动未来无线音频创新。作为全球应用最广的无线标准之一，蓝牙技术的不断迭代，将推动其从连接工具向智能中枢的转型。

②在私有无线技术方面，未来技术演进将围绕更高带宽传输能力、极致音质还原、超低延迟响应以及小型化无感化佩戴带来的低功耗能效展开。随着电竞游戏、直播和视频及无线家庭影院等细分场景对音频即时要求愈发严苛，私有协议将持续突破性能边界，同时向多模化方向演进，在确保高带宽、低延迟与高抗干扰性能的基础上拓展多应用场景。此外，AI技术的深度融入将赋予无线芯片智能化的环境感知与动态调优能力，根据使用场景自动切换协议模式、优化功耗与传输策略，实现音质、功耗、延迟、无线传输性能的动态平衡。

③工艺制程与IP不断前进，AI技术持续融合，主流无线音频SoC芯片制造商在向更先进的工艺制程迈进，以实现更高的集成度、更低的功耗和更强的性能。业内头部IP供应商也提出全面拥抱端侧AI战略，在计算效率、开发生态等多维度为产业提供更高效的IP解决方案。AI技术与无线音频SoC芯片的相互融合，也为智能穿戴、智能音频、智能陪护类产品带来更加智能化的产品体验。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,356,669,283.23	2,161,954,021.04	9.01	1,926,597,146.57
归属于上市公司股东的净资产	2,045,820,306.10	1,879,391,800.63	8.86	1,809,707,717.05
营业收入	922,378,714.01	651,875,446.08	41.50	520,099,364.94
利润总额	204,895,328.57	108,187,866.97	89.39	64,932,714.12
归属于上市公司股东的净利润	204,586,027.73	106,582,933.82	91.96	65,058,596.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,241,590.36	78,553,920.97	144.73	51,126,424.21
经营活动产生的现金流量净额	253,505,239.32	154,157,199.28	64.45	155,093,306.01
加权平均净资产收益率(%)	10.46	5.83	增加4.63个百分点	3.64
基本每股收益(元/股)	1.18	0.61	93.44	0.37
稀释每股收益(元/股)	1.17	0.61	91.80	0.37
研发投入占营业收入的比例(%)	26.13	33.00	减少6.87个百分点	31.80

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	19,195.15	25,716.89	27,301.70	20,024.12
归属于上市公司股东的净利润	4,144.97	4,992.57	6,027.13	5,293.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,861.61	4,728.85	6,067.81	4,565.88
经营活动产生的现金流量净额	3,487.19	10,582.43	8,763.64	2,517.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,247
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,233
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）	6,773,664	40,641,984	23.20	0	无	0	其他
珠海炬森投资合伙企业（有限合伙）	257,440	2,143,440	1.22	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基金	-200,000	2,100,000	1.20	0	无	0	其他
厦门炬上益投资合伙企业（有限合伙）	-592,194	1,759,844	1.00	0	无	0	其他
厦门炬上吉投资合伙企业（有限合伙）	-624,703	1,698,164	0.97	0	无	0	其他
珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）	-1,813,878	1,655,322	0.94	0	无	0	其他
珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙）	-520,862	1,572,803	0.90	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,510,083	1,510,083	0.86	0	无	0	境外法人
中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	1,359,378	1,359,378	0.78	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-信澳领先增长混合型证券投资基金	534,315	1,250,547	0.71	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人同为宏迅创建有限公司。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体参见本章节“二、经营情况的讨论与分析”的相关内容。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688049　证券简称:炬芯科技　公告编号:2026-008

炬芯科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.26元人民币（含税），资本公积不转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币239,201,666.65元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元人民币（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为174,280,495股，以此计算合计拟派发现金红利45,312,928.70元（含税）。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份688,036股，支付的资金总额为人民币23,135,626.47元（不含印花税、交易佣金等交易费用），公司在2025年10月已实施2025年半年度现金分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利174,428,049.50元（含税）；2025年半年度，年度现金分红和回购金额合计为85,876,604.67元，占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为41.98%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购额（以下简称“回购并注销”）金额2.00亿，现金分红和回购并注销金额合计62,740,978.20元，占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.67%。

截至2025年12月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份887,155股，不参与本次利润分配。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	炬芯科技	688049	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢枚芹	程奔驰
联系地址	珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区	珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号1#厂房一层C区
电话	0756-3673718	0756-3673718
传真	0756-3392727	0756-3392727
电子信箱	investor.relations@actionsatech.com	investor.relations@actionsatech.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

作为中国领先的低功耗AI IoT芯片设计厂商，公司专注于中高端智能音频SoC芯片的研发、设计与销售，深耕无线音频、智能穿戴、智能交互等AIoT核心场景，为行业提供高能效比的专业芯片产品与一体化解决方案；公司坚定践行品牌客户战略，以持续高强度技术研发筑牢产品核心竞争力，推动市场份额稳步攀升。

依托全场景AI音频布局，公司已构建起低功耗大算力芯片硬件架构、高性能音频链路及音频算法、高带宽低延迟无线连接技术、便捷高效的端侧 AI 开发工具四大核心技术壁垒，并率先布局存内计算（CIM）技术，CPU+DSP+NPU架构实现AI算力高效加速，从底层架构突破传统计算模式的存储墙与功耗墙瓶颈，与端侧AI对高能效比、低功耗、实时推理的核心要求高度契合，形成软硬件协同、算法与连接技术深度融合的差异化优势。

未来，公司将围绕硬件升级、算法迭代优化、无线连接技术拓展、生态体系搭建四大核心维度持续加码研发投入，不断强化存内计算等前沿架构在智能音频终端的规模化落地优势，逐步拓展应用边界，致力于成长为端侧 AI 多领域的领先芯片供应商。

公司芯片产品用例展示：

公司的部分终端品牌客户：

注:公司已进入上述终端品牌的供应链，上述终端品牌在报告期内非公司的直接销售客户。

公司的核心产品：

（1）智能无线音频SoC芯片系列:公司的智能无线音频SoC芯片主要应用于蓝牙音箱、无线麦克风、智能穿戴设备、无线家庭影院音响系统、无线电竞耳机、无线收发dongle等。

（2）端侧AI处理器芯片系列:

公司致力于提供智能物联网AIoT端侧低功耗算力的芯片平台，聚焦于端侧A目技术在音频领域的深度落地与创新应用，可为声纹识别、智能降噪与人声增强、波束成形、定向拾音、人声分离、回声消除、去混响、反馈抑制、音效增强、声场定位与调校、定向传声、多音轨分离与重混(包括人声、乐器等)、人声美化、变声、灯效、智能场景识别、情感识别、语音唤醒与识别、语义分析等为代表的众多实际应用场景提供充足的AI算力，可广泛应用在以Party音箱以及声卡、调音台、专业麦克风、会议系统、无线家庭影院音响系统等为代表的专业音频设备中。

2.2主要经营模式

作为集成电路设计企业，公司采用行业常用的Fabless经营模式，即专门从事集成电路的研发设计，晶圆制造和测试、芯片封装和测试均委托专业的集成电路制造企业、封装测试企业完成，取得芯片成品后对外销售。同时，为了缩短芯片产品的面市时间，降低客户的开发门槛，公司在提供SoC芯片的同时，提供完善的SoC软件开发平台（算法库、OS、SDK、应用软件和开发工具等），针对不同品类的特性以及市场需求，为客户提供融合软硬件和算法的整体解决方案。

1.研发模式

公司研发流程如下：

在立项阶段，各事业部根据市场调研情况提出市场需求，各研发部门根据市场需求文档提出各自领域的研发